

# 2017年9月份工作报告

报告人： 谭亮      日期： 2017/10/10

## 一、本季度订单交易情况小结

### 1. 客户订单情况

客户名称	产品类型	数量	金额
HUAWEI	T75B-H529-10.00MHz	6600	105791.4
国家频谱管理研究所	O22B-G426-100.00MHz	10	22000
广瑞泰	T75B-F319-40.00MHz-A	300	9600
成都讯隆	T75B-G511-50.00MHz	20	2400
Chronos	ACS9522IFALBGT	504	60041.52
成都华康新联科技	M21B-ESBD-10.00MHz	11	3850
北京华森国际	OS754-D31-90.00MHz	10	280
北京华森国际	V756-B712-125.00MHz	10	1250
北京华森国际	T75B-F319-10.00MHz	10	800
成都兴仁科技	M75B-H413-10.00MHz	10	2200
电子科大科技园	T75B-M319-80.00MHz	20	5200
汇总			213412.92

## 二、月度总结

### 2.1 海外市场

- A. 9月份海外市场，芯片主要就是 chronos 下了 504pcs 的 ACS9522 订单，预计 11 月份出货，其他客户没有订单。
- B. Chronos 有送样 O22B 高低两款样品，目前 O22B 高指标样品在测，低指标的等客户重新设计板子再测
- C. Leader 样品已经收到，客户端在等待 PCB 贴片组装测试中
- D. Valiant 晶振样品需求跟进，10 月份出货
- E. ACALBFI 晶振询价，样品之前有 T75 寄出，等待客户端测试反馈
- F. 其他客户保持联系，暂时没有实质需求

### 2.2 国内市场

- A. 华为 T75B 10.00MHz 订单稳定，6600pcs，比预测少 600pcs
- B. 华为 T75B 10.00MHz 因为 IQC 回流焊掉盖导致退货，原因在协助华为调查。相关文件已发给华为，评审现场发现的问题也提交整改的对策。华为 IQC 现场参观机会等待安排
- C. 华为 O11F 38.88M 替代测试目前已启动，预计 10 月份会完成，跟进成都和西安的测试情况及进度；可靠性测试预计 10 份完成，跟进夏工那边的最新情况
- D. O11H 10M 目前晶体延迟发货，预计最快能提供样品的时间要到 11 月底才能提供摸

底测试样品

- E. 华为 105 度宽温低噪 TCXO 目前方案还未最终定型，新来的谐振器温度特性达不到要求，1hz 相噪也不够余量
- F. 高保持方案，10 月中下旬再跟屈涛沟通，看他们那边的测试结果，是否给机会我们送样
- G. 陕西烽火电子 T53 16M 已出完货，款要 10 与份到期；备一点晶体库存，11 月份有可能还有订单
- H. 福建三元达，O22B 已出货，款 10 月份到期，T10A 也已出货。
- I. 珠海高凌，应军改，其网络产品需求暂停，跟进客户端最新的动静
- J. 广州慧睿思通，O11A 样品需求，10 月份发样品
- K. 其他小客户跟进一些样品订单
- L. 张振华客户，大多数客户都已电话沟通了一遍，通知了相关情况，一些客户的小订单下达。还有一些样品出货，逾期款追缴工作

### 三、新客户和 Design in

客户名称	项目	大普产品机会	状态	进度
Chronos	SyncBox	晶振 O22	Design in	目前在测试当中
ECI	Apollo	ACS9522	Design in	基本完成，批量订单要等招标等机会
CDOT	GPON	ACS9522 /晶振	Design in	4 季度完成测试
LEADER	仪器设备	ACS9522/晶振	Design in	样品已寄出等装配测试，预计 11 月
Valiant	网络	晶振	Design in	样品阶段
华为	传输	晶振 O11H	Design in	设计阶段，预计最快 11 月份有样品
华为	BBU/RRU	晶振 T75	Design in	研发阶段，样品暂无预期
华为	无线	晶振 O22	DO	沟通状态
慧睿思通	专网	晶振 O11	Design in	4 季度完成新板子设计测试
泽惠通	公安	晶振 CM66G	Design in	样品寄出，等客户测试
ACALBFI	网络设备	晶振 T75 T53	Design in	样品寄出客户重新设计板子 4 季度完成

### 四、下阶段工作计划

- B. 华为 38.88 跟进测试进度和可能出现的问题，把握招标进度
- C. 华为 O11H 10M 的项目推进，尽快能验证最终版本提供测试样品
- D. 华为保持项目跟进与屈涛的沟通，看是否有机会送样品测试
- E. 华为已有编码，做好预测和交付
- F. 华为退货事件的处理，争取能减少对大普的负面影响和打分
- G. 海外客户跟进芯片的 design in 机会，推进 LEADER /ECI/ Cytech 的进度
- H. 晶振跟进海外客户的需求，样品跟进测试
- I. 国内陕西烽火、三元达跟进其新的项目机会和老型号订单
- J. 成都张振华客户，全部再梳理一遍，确保所有客户订单下达到大普，其次，发掘已有客户的新需求，开发新的潜在需求客户

- K. 其他小客户需求跟进，保证能及时供应需求，往大的机会上引导的可能性
- L. 把握可能潜在的大的机会，如泽惠通的模块需求，ACAL 的 T75 需求；争取能拿到相对大的订单
- M. 新客户的开发，新的 **design in** 机会的把握，继续梳理之前联系的客户，看客户方面最近是否有新的变化；同时开发新的目标客户，寻找新的合作伙伴和机会

#### 五、主要问题及市场情况

- A. 华为项目 O11H 10M 的进度偏慢，时间在流失，最终留给替代测试的时间会不足
- B. 华为 105° TCXO 到目前为止尚未有可行的设计方案
- C. TCXO 方面我司与同级竞争对手有一定差距，体现在成本上，产品指标上。成本上市场上一般指标的 TCXO 成本比较低，有的都是消费类的价格；另外在低噪方面，我们还没有相应的系列产品，经常会有客户询问低噪 TCXO。